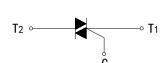
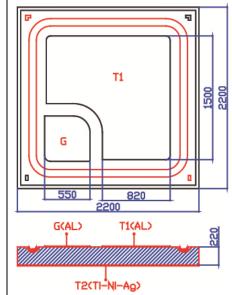
## JST220 型三、四象限双向晶闸管芯片

- 〇 芯片特征: 单面台面结构, 台面玻璃钝化工艺, 背面三层金属电极。
- 芯片尺寸: 2.2mm×2.2mm
- 可替换型号: BTA04/BTB04/BT136



(芯片代码: CP308)

## JST220芯片结构图(µm)



## ○产品极限参数(封装成 TO-220 后,除非另有规定, T<sub>CASE</sub> =25℃)

参数名称		符号	数 值	单 位
结温范围		Tj	-40~125	$^{\circ}$
正向断态重复峰	值电压	$V_{DRM}$	600/800	V
反向断态重复峰	值电压	$V_{RRM}$	600/800	V
通态均方根电流	T <sub>C</sub> =110°C	I <sub>T (RMS)</sub>	4	Α
通态浪涌电流	tp=20mS	I <sub>TSM</sub>	40	Α
	tp=16.7mS		41	
I <sup>2</sup> t 值	tp=10mS	l <sup>2</sup> t	8	A <sup>2</sup> S
通态电流临界上升率		dI/dt	50	A/uS
I <sub>G</sub> =2×I <sub>GT</sub> ,tr≤10	0ns, F=100Hz			
门极峰值电流	Tj=125℃	I <sub>GM</sub>	4	Α
门极平均功率	Tj=125℃	P <sub>G</sub> (AV)	1	W

## ○ 产品电性能 (封装成 TO-220 后,除非另有规定, T<sub>CASE</sub> =25°)

特性和测试条件	符号	数 值	单 位
		Т	
通态峰值电压 I <sub>TM</sub> =8.5A,tp=380uS	$V_{TM}$	≤1.55	V
正向断态峰值电流 T <sub>C</sub> =25℃	I <sub>DRM1</sub>	≤5	uA
$V_D = V_{DRM}$ $T_C = 125^{\circ}C$	I <sub>DRM2</sub>	≤1	mA
反向断态峰值电流 T <sub>C</sub> =25℃	I <sub>RRM1</sub>	≤5	uA
$V_R = V_{RRM}$ $T_C = 125$ °C	I <sub>RRM2</sub>	≤1	mA
门极触发电压 V <sub>D</sub> =12V, R <sub>L</sub> =30Ω	$V_{GT}$	≤1.3	V
门极不触发电压	$V_{\sf GD}$	≥0.2	V
$V_D = V_{DRM}$ , $R_L = 3.3 \text{K}\Omega$ , $Tj = 125 ^{\circ}\text{C}$			
门极触发电流 V <sub>D</sub> =12V, R <sub>L</sub> =30Ω	I <sub>GT</sub> ( I - II -III)	≤5	mA
	l <sub>GT</sub> (IV)	≤10	
擎住电流	I <sub>L</sub> ( ] -]]])	≤10	
I <sub>G</sub> = 1.2I <sub>GT</sub>	I <sub>L</sub> (IV)	≤20	mA
	I <sub>L</sub> ( ]] )	≤15	
维持电流 I <sub>T</sub> =0.2A	I <sub>H</sub>	≤10	mA
断态电压临界上升率 Tj=125℃	dV/dt	≥20	V/uS
V <sub>D</sub> =2/3V <sub>DRM</sub> ,门极开路			